

FINEDEL DSR-8000S18 HF-5

FINEDEL DSR-8000S18 HF-5 碱性显像型绿色液态防焊油墨。

- 本制品有良好的耐化金性。
- 本制品有良好的耐热性。
- 本制品为无卤素产品。

1、一般规格

Table 1、DSR-8000S18 HF-5 一般特性

项 目	规 格
色 调	绿 色
粘 度	160±40 dPa·s (BROOKFIELD HBT at 25°C)
比 重	1.4
不挥发成分	78 ±3 wt %
闪火点 (闭杯)	76°C
混合比率	主 剂: 750g 硬化剂: 250g
混合后有效期间 (保管于 20°C 以下的暗处)	两剂混合后 24 小时
储 龄 (保管于 20°C 以下的暗处)	两剂均为 6 个月

2、基板制程例



※1 UV 后曝光工程, 仅为提高涂膜在化金, 喷锡处理中使用活性较强之助焊液时执行。

※2 在后制程使用 UV 文字油墨时因文字油墨种类, 与防焊油墨贴紧性不同, 需仔细确认。

3、使用方法

本品是二液性，使用前将主剂 DSR-8000S18 HF-5 和硬化剂 CA-8000S18 按照 750g: 250g 之质量比混合，搅拌 30 分钟后使用。

混合搅拌后的油墨，务请在 24 小时以内使用(建议在 12 小时以内用完)。

4、使用时应注意事项

- (1) 清洗网版请使用酯类及塞苏类溶剂或者二者的混合溶剂。
- (2) 本制品无需稀释。若有必要粘调，请使用专用稀释剂 #2200。
- (3) 电路板经表面处理后，应避免手污染及油污，请尽快涂布印刷，避免污染表面。
- (4) 印刷油墨后的电路板，预烤温度以 75°C 为宜，因烤箱的类型、热容量、基板放入数量等因素而有所不同。在设定预烤温度前，请多做实验加以确认。
如果预烤不足，涂膜将发粘在曝光时粘底片；如果预烤过度，将导致显影不良。
- (5) 本品主剂属于指定可燃物可燃性液体类，硬化剂属于指定可燃物可燃性固体类，请避开在有火气之场所使用。
- (6) 本品主剂和硬化剂含有溶剂，请在有强制排气设备场所。
- (7) 本品保存于 20°C 以下阴暗处。

5、实验数据(仅供参考)

DSR-8000S18 HF-5 硬化涂膜的特性

Table 2、DSR-8000S18 HF-5 硬化涂膜的特性

项 目	性 能	试 验 方 法 及 条 件
1. 涂膜硬度	6H	JIS C 5012-1993 8.6.3 铅笔划痕试验 铅笔：三菱铅笔UNI 铜及基材上之涂膜
	6H	IPC-SM-840C 3.5.1 / TM2.4.27.2
2. 密着性	100/100	JIS C 5012-1993 8.6.2 百格试验 透明胶带：JIS Z 1522 宽12mm 铜及基材上之涂膜
	合格	IPC-SM-840C 3.5.2.1 / TM 2.4.28.1 铜箔及基板上的涂膜应无剥离
3. 感度	10 段	油墨表面上 350mJ/cm ² Kodak Step Tablets 21 格
4. 解像度	60 μm	油墨表面上 350mJ/cm ² (预烤后) 膜厚 wet35 μm 试验基板：QFP 组装用，具 50 μm 厚铜板
5. 耐溶剂性	涂膜无异常	IPC-SM-840C 3.6.1.1 涂膜应无起泡、剥离、变色等情形发生。 异丙醇： 室温 2 分钟
		单甲基醚丙二醇乙酸酯： 室温 60分钟
6. 耐药品性	涂膜无异常	10%硫酸 室温 20 分钟
		10%氢氧化钠 室温 60 分钟
7. 焊锡耐热性 ※1	涂膜无异常	JIS C 5012-1993 10.5.1 浸锡方法 施以胶带拉扯试验后，观察涂膜外观。应无起泡、剥离等情形发生。 助焊液：SLDERRITE MH-820V 锡炉温度：260℃，浸泡 10 秒×3 次
8. 耐化金性 ※2	涂膜无异常	涂膜应无起泡、剥离、变色等情形发生。 化金(无电解) Ni:3 μm Au:0.05 μm 外观：胶带剥离

※1 涂膜异常的发生与否，因所选用助焊液的种类而异。因此选用助焊液前，请多做试验。

※2 涂膜异常的发生与否，常因镀(化)金槽的条件而异。因此在设定条件前，请多做试验。

注：上述试验结果为上海田村研发实验室测试结果(使用基板铜厚为 1QZ)，各该数值仅供参考，并非保证值。